公司代码:688519　　公司简称:南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.ccl-china.com/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润,具体利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本234,400,000股,回购专用证券账户中股份总数为2,457,950股,以此计算合计拟派发现金红利57,985,512.50元(含税)。本年度公司现金分红(包括以现金方式回购股份计入现金分红的情况)占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.54%。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的,则以未实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议后方可实施。

8 是否存在公司的特殊发行等需要事项

□是 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	南亚新材	688519	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张柳	郑小芳
办公地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
电话	021-69178431	021-69178431
电子信箱	nanya@ccl-china.com	nanya@ccl-china.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料,印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件,被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。

2.主要产品及服务情况

公司主要产品为覆铜板及粘结片,具体如下:

(1)覆铜板

覆铜板(Copper Clad Laminate,简称 CCL)全称为覆铜箔层压板,是将增强材料浸以树脂胶液,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,是制作印制电路板的核心材料。覆铜板性能直接影响电路板导电、绝缘、支撑三大功能,对电路板的信号传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。

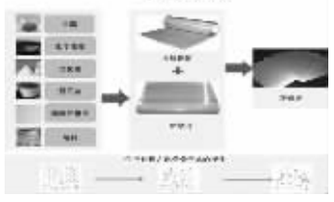
由于下游应用领域众多且性能需求各有差异,公司的产品明细规格多达几千个,按照胶系(树脂配方体系)大致可以分类为普通 FR-4,无铅兼容型 FR-4(以下简称“无铅板”),无卤无铅兼容型 FR-4(以下简称“无卤板”)和高频高速及其他覆铜板。具体情况如下所示:

类别	代表型号	终端应用领域
普通板系列	NY1140、NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板系列	NY2140、NY2150、NY2150H、NY2170、NY2170H、NY2600	手机、电脑、仪表仪器、汽车电子、光伏等
无卤板系列	NY3150HF、NY3150HC、NY3170HF NY3170HC	智能终端、笔记本电脑、硬盘、内存、服务器、汽车电子等
高频高速板系列	NOUYA2G+、NOUYA4G+、NOUYA6、NOUYA6G、NOUYA7、NOUYA7+、NOUYA8、NOUYA-L(LOW CTE)、NYHP-5L、NYHP-30、NYHP-5P、NYHP-5P+、NYHP-6A、NYHP-MW、NYHP-55、NYHP-65、NYHP-3A、NY-6IC	核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心、天线、功放、雷达、射频模组等
车用板系列	NY-A1、NY-A2	汽车电子、充电桩;

(2)粘结片

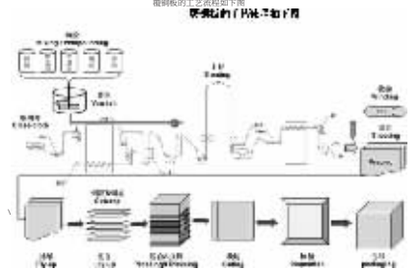
粘结片(Prepreg,简称PP)又称半固化片,系覆铜板生产过程中的前道产品,粘结片在较大程度上决定了覆铜板的整体性能,系覆铜板产品的配方技术与核心附加值之体现。

覆铜板和粘结片的关系



下游多层板或HDI客户向覆铜板厂商采购覆铜板的同时,往往需要配套采购同厂商同规格的粘结片产品,用其作为多层板或HDI层与层之间的粘结和绝缘材料。粘结片的销售情况能很好地反映出覆铜板厂商服务于多层板或HDI等中高端领域的综合能力。

覆铜板的工艺流程如下图



(二) 主要经营模式

公司一贯秉承“以人为本、集思广益、持之以恒、共创未来”的企业发展精神,贯彻“不断导向、管理创新、质量至上、技术领先”的经营方针,科学管理、不断创新、稳健发展。公司紧跟行业及市场的发展趋势与需求,始终践方于“成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司”,通过执行严格的质量标准、采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施,为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务。

公司产品通过了COC产品认证、德国VDE产品认证、日本JET产品认证、美国UL安全认证。公司采取系统的质量控制体系,先后通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证、QC080000危害物质过程管理体系。

公司凭借多年的技术积累和品牌建设,已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势,在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与奥士康、方正科技、广东骏亚、沪电股份、崇辉博、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等知名PCB厂商建立了长期良好的合作关系。被深南电路、健鼎科技等评为“优秀供应商”。

1.研发模式

公司根据行业技术发展动态并结合市场调研结果,制定研发项目计划并向研发中心下达研发任务,评审立项后进入新产品的配方开发、内部测试、打样测试、量化转产、配方持续优化等阶段。产品研发主要以产品配方优化升级和新产品开发为主。

(1)产品配方优化升级主要考虑成本优化和性能升级。公司根据市场变化及客户需求,对成熟产品原有配方技术进行更新升级达到成本优化或性能升级或两者兼具,以满足客户需求,增强市场竞争力。

(2)新产品开发主要为公司战略研发产品的开发或头部终端技术合作的新品开发。由公司根据中长期战略目标或头部终端新品技术合作需求明确研发方向后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本、调研分析后提交公司审批立项。其中,项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。

2.采购模式

公司生产所需的原材料主要为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等。公司高度重视原材料供应体系建设,已建立合格的供应商评价体系,通过与上游知名供应商建立稳定的战略合作关系,保证原材料供应的稳定。公司采购部门负责定期询价,根据原材料需求计划,综合考虑交期因素、在询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同。

3.生产模式

公司实行“以销定产及需求预测相结合”的生产模式。公司以市场需求为导向,根据已接订单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划。生产部门根据生产计划严格按照工艺标准组织生产,按时、保质保量的提供满足客户需求的产品。在质量控制体系上,公司实行全面质量管理,全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。

4.销售模式

公司坚持以客户为中心,“持续为客户创造更大的价值”,实现客户与公司可持续性共赢发展。产品销售以直销为主,以终端(OEM/ODM)及PCB客户需求为方向,持续扩大市场品牌影响及市场份额为目标,积极主动开发各领域内客户及新项目,采取“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”销售策略。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.行业发展阶段及其基本特点

(1)产业政策支持,发展前景明朗

公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。

信息技术产业是关系国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。电子专用材料是支撑信息技术产业发展的基石,是保障产业链、供应链安全稳定的关键,电子专用材料行业发展不充分,将导致其下游产业如高性能高精密线路板、芯片封装、半导体等密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域被卡脖子、被迫进口原材料,形成“卡脖子”困境。所以电子专用材料行业与信息技术产业互相配进,不可分割,具有广阔的发展前景。近年来,国家颁布了一系列政策法规,将信息技术和电子专用材料列为战略性新兴产业之一,大力支持其发展。

(2)电子信息产业迁移,国内供应链趋于成熟

本世纪以来,随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴经济体内部转移,目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国和欧洲等区域,作为PCB产业上游,全球覆铜板制造企业主要分布也基本存在分化趋势。据Prismark统计及预测,2020年全球PCB产值为652亿美元,较2019年增长了6.4%。其中,中国大陆产业产值约300.1亿美元,占全球产值份额的46.07%,较上年增长6.6%。2020年全球CCL行业产值达到129亿美元,较上年增长4.9%,其中中国大陆及香港CCL产值接近92亿美元,占全球产值份额超71%,已经成为全球覆铜板主要生产制造基地。

(3)新能源汽车、5G通讯等新兴应用,市场需求进入新发展

覆铜板的终端应用几乎涉及所有的电子产品。随着5G技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展,给覆铜板产业带来了全新的发展机遇,也提出了更高的要求和标准。现阶段,市场需求主要体现在以下几个方面:

1.高速高频产品应用扩大,低损耗、高速传输成为主流,且该类产品及其原材料的国产化需求迫切,稳定且优质的供应链成为重中之重;

2.汽车电子电动化、智能化成为大趋势;

3.载板及类载板材料需求量将急剧攀升;

4.轻薄化、无卤化且低损耗、低翘曲成为常态需求。

为适应电子信息市场发展趋势,近年来国内外覆铜板材料产品技术发展主要集中在以下几个方面:

1.高速PCB用低Dk和DI覆铜板;

2.高频微波用覆铜板;

3.高密度互连(HDI)和系统封装(SIP)用薄型高可靠性系列材料(包括芯板和粘结片、RCC、埋容材料);

4.高导热、高散热性覆铜板材料;

5.IC封装用高性能电子电路基材;

6.高多层(16层或更多层)上PCB)印制电路板用高性能覆铜板及粘结片系列材料;

7.无铅化或性能高可靠性覆铜板;

8.无卤化环保型系列覆铜板等。

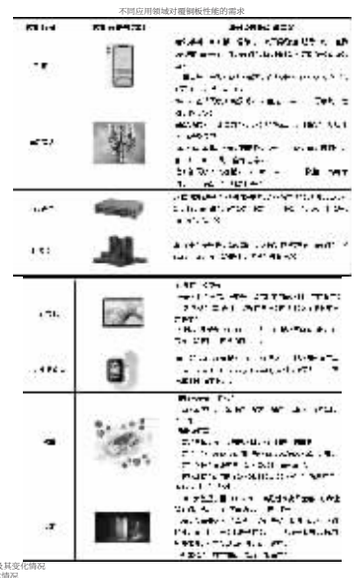
同时,国内领先的覆铜板同行份额已进入质、量、价三方面并重发展的新阶段,针对不同等级产品进行差异化布局。高阶产品,核心布局高速、高频及载板材料,特别是60Gbps(含)以上产品,并重点通过关键终端认证以期实现批量化生产;中阶产品,以降低成本、提升质量管控、性能稳定为重心,提升市场占有率;低阶产品,侧重成本管控,提升产品性价比,实现产能满产稳动,扩大盈利能力。

2.主要技术门槛

覆铜板的终端应用广泛而复杂,且下游技术更新换代不断加快,故对覆铜板企业的综合技术创新能力要求较高,而其研发及制造技术又是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高新技术,是一个复杂的系统工程。随着行业技术的不断升级换代,覆铜板企业不仅需要全面掌握并提升生产工艺、控控好品质的同时降低成本,确保生产出价优质好的产品,更需要应对终端不断提升的技术新需求研发创新出适用于市场的新品。

覆铜板的配方技术、生产工艺、品质控制均极其复杂,其中,配方技术是覆铜板企业最主要的技术、基本体现覆铜板的核心性能,是本行业最大的技术门槛。其难点在于如何从数以千计的低分子化合物中筛选选配原材料构建最佳反应配比组合,以实现产品在物理性能、化学性能、介电性能、环境性能等方面的最佳表现,另外还需考虑成本、性价比因素以满足量产和大规模应用需求。随着科技的进步及终端市场的需求变化,不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应技术与市场的快速发展。

不同应用领域对覆铜板性能的需求



2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司所处行业分析及变化情况

全球覆铜板产业历经60年左右的发展历史,主要经历了三个时期,美国企业主宰市场时期、日本企业主导市场时期和多极化发展时期。不同发展阶段主导企业的分布一定程度上体现了覆铜板产业的全球市场逐渐由欧美发达国家转移至亚洲地区,尤其是中国大陆。据Prismark统计,2020年整个亚洲地区CCL产值占全球产值为97.3%,其中中国大陆及香港地区CCL产值占全球产值的71.1%。

从行业整体竞争格局来看,外资企业仍占据着全球高端覆铜板市场的主要市场份额。与内资企业相比,外资企业在技术、品牌和资金实力方面具有比较明显的优势,基本上属于行业的高端市场。不过经过多年的技术积累与迭代发展,近年来,我国本土企业中也逐步涌现出了一批以公司为代表的优秀内资企业与国外企业展开竞争。

(2)公司的技术实力和经营特点

电子信息产业发展为覆铜板行业提供了广阔的市场空间。随着产业链往中国本土的转移,公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势,已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。

自2000年设立以来,公司始终专注并深耕于覆铜板及粘结片业务,已形成自身独特的核心配方体系以及生产工艺体系,并围绕该些技术体系,形成了相关专利及非专利技术,能满足下游中、高端客户的严苛的技术要求。历经20余年的孜孜耕耘和自主创新,公司产品技术日益完善,业务品牌逐步做强,已逐步追上外资领先厂商的技术水准,在中高端产品上已实现了进口替代。近年来,随着5G建设的推进,公司在高速、高频等高端覆铜板产品领域重点投入,全面布局,是目前唯一一家各个质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业,产品性能与国际先进同行同类产品相比,水平相当或更为优异,已能实现进口替代。此外,公司完善了高频领域碳氢、PTFE系列的产品。2021年第四季度始,公司高速高频覆铜板销量提升明显。

公司在长期经营过程中形成了自身差异化的经营特色:凭借持续技术创新、出众的产品性能以及快速的服务响应,坚定走“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”市场营销策略,积累了奥士康、沪电、健鼎、景旺、胜宏、深南、世运等众多优质直接客户,并与华为、瀚朝、三星、中兴等一大批知名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着H47”的全面出产及N47”的陆续投产,公司产能充足,具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力,预计2022年,随着5G通讯、汽车电子等领域的快速推进,市场前景十分广阔。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)中长期内,亚洲经济持续主导全球PCB产业,中国的核心地位持续提升,叠加坚新冠疫情和国际贸易摩擦影响,将给内资覆铜板在国际竞争中带来良好的发展契机。

据Prismark统计及预测,2020年全球PCB行业销售额为652.19亿美元,未来五年全球PCB行业产值将持续稳定增长,到2025年全球PCB行业产值将达到762.18亿美元,预计2020年至2025年期间复合增长率为3.1%。其中中国2020年PCB行业销售额为350.09亿美元,全球市占率达53.7%,到2025年销售额将达到372.18亿美元,预计2020年至2025年年均复合增长率为3.5%,且全球市占率持续上升。PCB产业的高成长性将带动上游CCL产业,2020年全球覆铜板销售额达129.96亿美元,较上年增长了4.36%,预计2025年覆铜板产值将达到174.12亿美元,年均复合增长率达到6.2%。随着PCB产业的内移,国内CCL行业经过多年的技术积累与迭代发展,凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势,迎来了一轮发展契机。2020年中国覆铜板销售额达92.34亿美元,较2019年销售额提升7.5%,全球市占率达71.6%。

全球覆铜板市场预测

单位:亿美元

年　份	2019年	2020年	2025年	2020-2025CAGR
营收总额	123.59	128.96	174.12	6.2%

数据来源:Prismark.

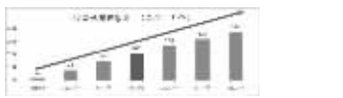
(2)随着5G技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展,将开启万物互联、人机交互的新时代,给覆铜板产业带来了全新的发展机遇。

① 5G及数据中心建设向纵深方向发展,高频高速板市场空间广阔

国家对新一代信息技术十分重视,在《中国制造2025》、“十三五”及“十四五”规划纲要等文件中,均将5G技术列为战略重点发展领域。随着5G的规模化应用,将带来电子信息产业的重大变革,从前期的宏基站与微基站建设、交换机与路由器升级、服务器与存储器更换,到后期的智能终端、大数据、人工智能、物联网等应用渗看,未来5G将是每进步一步经济或长的关键动能。

与此同时,5G技术将拉动整个产业链产品向高阶材料升级。

如5G基站建设,2021年在2020年基础上基本翻番,达到140万个左右。目前基站的5A模式走向全区域快速广泛布局(增量),mmWave模式走向特定密集人群,信息需求爆发单元布局(增效),预计2022年累计5G基站建设将超过200万个。根据国家《“十四五”信息通讯行业发展规划》,到2025年,每万人拥有26个基站,5G建设将呈现高增长态势,将推动高频高速材料快速起量。



资料来源:根据公开资料整理预估。

除了通讯网络建设之外,运营商和设备商还聚焦在算力方面,最突出的代表是互联网数据中心(IDC)。由此,将为高端服务器、交换机、企业路由器、存储等产品带来极大的机会。如服务器PCIE4.0在2022年将进入主要量产期,PCIE5.0在2022年下半年也将进入量产,将推动高速材料从LL等级进阶至VLL等级,2022年企业路由器、交换机也将以25Gbps为主体进阶到56Gbps,甚至112Gbps时代,甚至将高速材料从VLL等级进阶至ULL等级。

2022年Intel/AMD新一代处理器将进入到PCIe5.0时代,也将全面支持DDR5,存储产品的传输速率也将实现倍增,由此也带来了VLL及以上等级材料的量产应用。此外,在信息及数字时代,算力为根本的基础下,GPU、DPU、Smart-NIC等PCB产品亦进入到VLL、ULL等级覆铜板材料的时代。

根据Prismark统计,全球2020年高频高速覆铜板市场为20.8亿美元,同比增长17.03%,其中高速覆铜板销售额达到2.03亿美元,同比增长17.03%,其中高频覆铜板的销售额为6.23亿美元,在2024年将达到5.53亿美元。2020年高频高速覆铜板企业市场份额左半由台资企业占据,其次是日本和美国企业,分别为20.3%和12.5%,内资企业仅占7.3%。目前,国内PCB及CCL企业在5G基站领域已基本掌握核心技术,均将带动上述领域用高频高速覆铜板市场的快速发展。

② 汽车产业进入智能网联时代,国内车用板将迎来高端增长

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展,汽车与能源、交通、信息通讯等领域相关技术加速融合,尤其是为汽车电子、电动化、优化能源结构,全球多国纷纷战略规划,科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业的发展,新能源汽车发展势头强劲。

中国已成为全球第一大汽车市场,为全球汽车产业发展注入了强劲的动力。根据最新消息,2021年,全球汽车总销量约8105万辆,同比增长4%,其中我国汽车总销量约2627.5万辆,同比增长3.8%,我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一,作为汽车大国的地位进一步巩固。同时我国在汽车“新四化”方面取得巨大进步,2021年全球新能源车累计销量近650万辆,我国新能源销量达到352.1万辆,同比增长157.6%,占全球新能源销量54.2%,连续七年位居全球第一,成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。展望给,2022年我国汽车总销量预计达到2760万辆,其中新能源汽车将达到500 万辆,同比增长42%,发展势头持续向好。

电动化、智能化、网联化等加速推进汽车产业转型升级,带动汽车板空间扩大,汽车PCB有望实现超行业平均增速增长。据相关机构预测,新能源汽车板2021-2025年市场空间CAGR为51%。汽车PCB增长动力主要来自于新能源汽车的渗透及单车PCB价值量提升。2021年全球新能源汽车销量占全球汽车总销量比重从2020年4%提升至8%,其中我国新能源车销量占我国汽车总销量比重从2020年的5%大幅提升至13%,新能源汽车渗透率持续提升。传统燃油车单车PCB平均用量约1m2,单车平均价值量仅为850-70,受益于汽车四化,单车PCB增量明显,如新能源车电动化带来电池、电机、电控三大核心系统增量,从而带动单车相关PCB增量约2000元,且不同自动驾驶等级单车价值亦呈现显著增长,随着供了新的卡位机会,如小鹏、蔚来、理想等中国“造车势力”崛起,国内新势力的快速发展有利于导入国内供应商,这些均给国内PCB企业及上游CCL企业带来极大的发展机会。

资料来源:公开资料整理

此外新能源汽车基础设施建设也将逐步完善。高速公路快充网将加快构建,5G、智能交通等新型基础设施建设也在逐步部署并完善。这些均将为汽车电子带来全新的增量市场。

③消费电子持续创新且需求扩大,覆铜板市场增量明显

随着全球消费升级趋势的展开,消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费,AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、可穿戴设备等消费热点频现,随着5G通信的全面、深度渗透,以人工智能AI、AIOT、可穿戴、便携式消费电子,智能家居为代表的创新型消费电子产品层出不穷,已渗透到消费者生活的方方面面,各细分领域市场增长潜力较大。叠加5G通讯基础设施的全球持续影响,移动办公、远程会议、网络教育等能迅电脑、平板、手机等电子产品需求提长;Mini-LED的技术发展,显产化成本降低推动了应用深化,带动高端显示等产业创新的增长,并有望成为下一年度的PCB及电子新增长点。

据Prismark统计及预测,2020年个人电脑PCB应用市场达111.88亿美元,较2019年增长了22.2%,预计到2025年达到将137.69亿美元,2020年至2025年年均复合增长率将达到4.2%;2020年移动电话PCB应用市场将达到139.8亿美元,较2019年增长了5.5%,预计到2025年将达到198.6亿美元,2020年至2025年年均复合增长率将达到7.3%;2020年消费类产品PCB应用市场为94.66亿美元,较2019年增长了25%,预计到2025年达到将116.4亿美元,2020年至2025年年均复合增长率将达到4.4%。消费电子PCB应用市场的提升将同步提升上游CCL市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

(下转B218版)

证券代码:688519　证券简称:南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	951,023,321.84		14.31
归属于上市公司股东的净利润	71,003,321.08		-7.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,916,714.39		-35.24
经营活动产生的现金流量净额	-58,410,051.90		不适用
基本每股收益(元/股)	0.30		-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.30		-9.09
加权平均净资产收益率(%)	2.42		减少0.51个百分点
研发投入合计	59,535,643.71		45.77
研发投入占营业收入的比例(%)	6.26		增加1.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,841,947,214.31	5,062,190,403.51	-4.35
归属于上市公司股东的所有者权益	2,931,370,481.89	2,893,849,389.09	1.30

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,654,078.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,171,234.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,891.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,686,814.13	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	25,086,606.69	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35.24	主要系产品销售价格有所回落,部分原材料价格仍处于较高位,导致毛利率收窄及公司同期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售商品、提供劳务所收到的现金及政府补助增加所致
研发投入合计	45.77	主要系为适应市场、客户需求,持续提升产品性能增加研发投入所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海南亚科技集团有限公司	境内非国有法人	126,048,600	53.78	126,048,600	126,048,600	无	0
深圳市前海恒邦兆丰资产管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金	其他	12,430,279	5.3	0	0	无	0
包秀银	境内自然人	8,755,543	3.74	8,755,543	8,755,543	无	0
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	未知	3,599,672	1.54	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,854,900	1.22	0	0	无	0
包秀春	境内自然人	2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0
南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2,457,950	1.05	0	0	无	0
郑晓远	境内自然人	2,413,910	1.03	0	0	无	0
郑海荣	境内自然人	2,263,674	0.97	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	未知	2,224,709	0.95	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市前海恒邦兆丰资产管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金	12,430,279	人民币普通股	12,430,279
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	3,599,672	人民币普通股	3,599,672
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	2,854,900	人民币普通股	2,854,900
南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	2,457,950	人民币普通股	2,457,950
郑晓远	2,413,910	人民币普通股	2,413,910
郑海荣	2,263,674	人民币普通股	2,263,674
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	2,224,709	人民币普通股	2,224,709
张东	1,940,129	人民币普通股	1,940,129
郑元超	1,889,918	人民币普通股	1,889,918
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	1,605,590	人民币普通股	1,605,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东;包秀银、包秀春为一致行动人;郑海荣、郑晓远为父子关系;张东为公司董事、总经理;金建中为公司监事会主席,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:南亚新材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	628,411,130.28	532,622,200.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	253,055,222.60	603,026,224.36
衍生金融资产		
应收票据	463,389,889.29	604,208,743.67
应收账款	1,506,262,010.41	1,644,841,340.70
应收款项融资	225,564,402.63	73,262,251.49
预付款项	8,393,838.46	10,119,433.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	884,677.71	615,471.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	396,899,674.79	396,108,930.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,017,780.54	30,146,480.56
流动资产合计	3,510,838,625.81	3,893,960,076.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	767,064,609.46	628,288,289.49
在建工程	401,595,304.79	385,856,737.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,578,377.22	12,476,402.37
无形资产	51,645,447.16	51,929,891.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,161,053.54	1,146,591.14
递延所得税资产	52,064,645.30	48,179,866.18
其他非流动资产	44,009,151.06	40,363,548.99
非流动资产合计	1,331,108,588.50	1,168,240,327.22
资产总计	4,841,947,214.31	5,062,190,403.51
流动负债:		
短期借款	300,271,816.96	300,277,638.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,283,075.63	394,322,701.06
应付账款	808,906,101.88	738,114,467.81
预收款项		
合同负债	3,408,348.23	1,618,170.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,881,299.51	56,839,142.09
应交税费	32,115,046.91	33,743,014.12
其他应付款	99,356,627.76	84,098,907.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,298,062.03	3,266,918.74
其他流动负债	326,066,872.56	356,503,519.17
流动负债合计	1,712,587